

## 立法會參考資料摘要

### 《進出口條例》 (第 60 章)

### 《2015 年進出口(戰略物品)規例 (修訂附表 1)令》

#### 引言

工業貿易署署長藉制定《2015 年進出口(戰略物品)規例(修訂附表 1)令》(下稱“該命令”)以修訂《進出口(戰略物品)規例》(香港法例第 60 章，附屬法例 G)(下稱“該規例”)附表 1。該命令載於附件 A。

#### 理據

2. 該規例賦予政府當局權力對進口、出口和轉運戰略物品實施許可證制度加以規管。在某些情況下，亦可對過境戰略物品實施規管。工業貿易署負責實施有關許可證制度，香港海關則負責有關執法工作。

3. 該規例附表 1 列出受管制的戰略物品，包括同時可作工業和軍事用途的物料、裝備、軟件和技術。附表 1 的清單是根據各國際防止武器擴散組織和有關公約(包括瓦塞納安排、澳洲集團、導彈科技管制組織、核供應國集團和《化學武器公約》)所採納的清單而擬定。根據《進出口條例》(香港法例第 60 章)第 6B 條的規定，工業貿易署署長可藉在憲報刊登命令，加入或刪除附表 1 中某項或某類物品。

4. 工業貿易署署長不時參考各國際防止武器擴散組織和有關公約所採納的管制清單以修訂該規例附表 1 的戰略物品管制清單。上一次對該規例附表 1 的修訂已於

2013 年 7 月生效。

## 《2015 年進出口(戰略物品)規例(修訂附表 1)令》

5. 該命令修訂有關規例的附表 1，以反映香港自 2013 年修訂該規例附表 1 的戰略物品管制清單後，相關國際組織對其戰略物品管制清單所作的變更。這些變更大致上反映相關國際組織對主要用於工業用途，亦適用於軍事用途的戰略物品(例如若干電子記錄裝備和數字式電腦)持續放寬管制，但把較敏感物品(例如與入侵軟件有關的若干裝備)納入管制。此外，我們亦藉此機會對該規例附表 1 中一些有關物品之描述作出輕微文本上的修訂，以求用詞一致及清晰，這些文本上的修訂不會影響管制清單的實質內容。

6. 有關修訂生效後，業界可獲免除就部份以往受該規例管制，但於該命令下放寬規管的戰略物品向工業貿易署申請進出口許可證。商界應會歡迎相關修訂。將被納入管制清單內的物品在香港的貿易活動並不顯著。

### 立法程序時間表

7. 我們將於 2015 年 1 月 30 日在憲報刊登該命令，並於 2015 年 2 月 4 日向立法會提交該命令。

8. 我們計劃由 2015 年 4 月 20 日起實施該命令，並於 2015 年 4 月 17 日在憲報刊登有關該生效日期的公告。這項安排可讓商戶就放寬對若干戰略物品的管制而得以盡早受惠。

### 建議的影響

B

9. 該命令對經濟的影響載於附件 B。該命令符合《基本法》，包括有關人權的條文。該命令不會影響該規例具有的約束力，而對財政、公務員人手、生產力、環境或可持續發展均沒有影響。

## 公眾諮詢

10. 該命令所作的修訂純屬技術性修訂，我們認為無需進行公眾諮詢。我們已就有關修訂透過戰略物品客戶聯絡小組向業界代表作出簡介，他們沒有就有關修訂提出反對。

## 宣傳

11. 該命令於 2015 年 1 月 30 日在憲報刊登，工業貿易署會在同日發出新聞稿，並透過貿易通告，以及透過部門網頁向商號宣告修訂管制清單的詳情，亦會安排發言人解答傳媒的查詢。

## 查詢

12. 如對本參考資料摘要有任何查詢，請致電 2398 5554 與工業貿易署首席貿易主任袁偉芳女士聯絡。

工業貿易署  
2015 年 1 月 28 日

附件 A

《2015年進出口（戰略物品）規例  
(修訂附表1)令》

該命令的副本載於本附件。

## 《2015 年進出口(戰略物品)規例(修訂附表 1)令》

(由工業貿易署署長根據《進出口條例》(第 60 章)第 6B 條作出)

### 1. 生效日期

在本條例第 6B 條的規限下，本命令自工業貿易署署長以憲報公告指定的日期起實施。

### 2. 修訂《進出口(戰略物品)規例》

《進出口(戰略物品)規例》(第 60 章，附屬法例 G)現予修訂，修訂方式列於第 3 條。

### 3. 修訂附表 1(戰略物品)

(1) 附表 1，中文文本，兩用物品清單，類別 3，項目 3A，註釋 2，注意 —  
廢除  
“或 3A001(a)(13)”

代以  
“及 3A001(a)(13)”。

(2) 附表 1，兩用物品清單，類別 3，項目 3A001(a)，註釋 2 —  
廢除  
“光集成電路”。

代以  
“光集成電路”；  
“三維集成電路”。

(3) 附表 1，兩用物品清單，類別 3，項目 3A001(a)(5)(a)(1) —  
廢除

“5 億”

代以

“10 億”。

(4) 附表 1，兩用物品清單，類別 3，在項目 3A001(b)(1)之前 —

加入

“技術註釋：

就項目 3A001(b)而言，在產品資料單張中，參數峰值飽和功率輸出可稱為輸出功率、飽和功率輸出、最大功率輸出、峰值功率輸出或峰包功率輸出。”。

(5) 附表 1，兩用物品清單，類別 3，項目 3A001(b)(2) —

(a) 廢除在註釋之前的所有字句

代以

“(2) 符合任何下述說明的微波“單塊集成電路”(MMIC)功率放大器：

(a) 額定於 2.7 千兆赫以上至 6.8 千兆赫(包括 6.8 千兆赫)的頻率操作，而“分頻寬”超過 15%，並具有任何下述特性：

(1) 在 2.7 千兆赫以上至 2.9 千兆赫(包括 2.9 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 75 瓦(48.75 dBm)；

(2) 在 2.9 千兆赫以上至 3.2 千兆赫(包括 3.2 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 55 瓦(47.4 dBm)；

(3) 在 3.2 千兆赫以上至 3.7 千兆赫(包括 3.7 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 40 瓦(46 dBm)；

- (4) 在 3.7 千兆赫以上至 6.8 千兆赫(包括 6.8 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 20 瓦(43 dBm)；
- (b) 額定於 6.8 千兆赫以上至 16 千兆赫(包括 16 千兆赫)的頻率操作，而“分頻寬”超過 10%，並具有任何下述特性：
  - (1) 在 6.8 千兆赫以上至 8.5 千兆赫(包括 8.5 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 10 瓦(40 dBm)；
  - (2) 在 8.5 千兆赫以上至 16 千兆赫(包括 16 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 5 瓦(37 dBm)；
- (c) 額定於 16 千兆赫以上至 31.8 千兆赫(包括 31.8 千兆赫)的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 3 瓦(34.77 dBm)，而“分頻寬”超過 10%；
- (d) 額定於 31.8 千兆赫以上至 37 千兆赫(包括 37 千兆赫)的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 0.1 納瓦(-70 dBm)；
- (e) 額定於 37 千兆赫以上至 43.5 千兆赫(包括 43.5 千兆赫)的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 1 瓦(30 dBm)，而“分頻寬”超過 10%；
- (f) 額定於 43.5 千兆赫以上至 75 千兆赫(包括 75 千兆赫)的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 31.62 毫瓦(15 dBm)，而“分頻寬”超過 10%；
- (g) 額定於 75 千兆赫以上至 90 千兆赫(包括 90 千兆赫)的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 10 毫瓦(10 dBm)，而“分頻寬”超過 5%；

- (h) 額定於 90 千兆赫以上的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 0.1 納瓦(-70 dBm)；”；
- (b) **廢除註釋 2**  
代以
  - “2. 如 MMIC 的額定操作頻率，涵蓋列於超過一個頻率範圍(由項目 3A001(b)(2)(a) 至 3A001(b)(2)(h)所界定)的頻率，該 MMIC 的管制狀況，須按當中最低的峰值飽和功率輸出限度斷定。”。
- (6) 附表 1，兩用物品清單，類別 3 —  
**廢除項目 3A001(b)(3)**  
代以
  - “(3) 符合任何下述說明的離散微波晶體管：
    - (a) 額定於 2.7 千兆赫以上至 6.8 千兆赫(包括 6.8 千兆赫)的頻率操作，並具有任何下述特性：
      - (1) 在 2.7 千兆赫以上至 2.9 千兆赫(包括 2.9 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 400 瓦(56 dBm)；
      - (2) 在 2.9 千兆赫以上至 3.2 千兆赫(包括 3.2 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 205 瓦(53.12 dBm)；
      - (3) 在 3.2 千兆赫以上至 3.7 千兆赫(包括 3.7 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 115 瓦(50.61 dBm)；
      - (4) 在 3.7 千兆赫以上至 6.8 千兆赫(包括 6.8 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 60 瓦(47.78 dBm)；
    - (b) 額定於 6.8 千兆赫以上至 31.8 千兆赫(包括 31.8 千兆赫)的頻率操作，並具有任何下述特性：

- (1) 在 6.8 千兆赫以上至 8.5 千兆赫(包括 8.5 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 50 瓦(47 dBm)；
- (2) 在 8.5 千兆赫以上至 12 千兆赫(包括 12 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 15 瓦(41.76 dBm)；
- (3) 在 12 千兆赫以上至 16 千兆赫(包括 16 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 40 瓦(46 dBm)；
- (4) 在 16 千兆赫以上至 31.8 千兆赫(包括 31.8 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 7 瓦(38.45 dBm)；
- (c) 額定於 31.8 千兆赫以上至 37 千兆赫(包括 37 千兆赫)的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 0.5 瓦(27 dBm)；
- (d) 額定於 37 千兆赫以上至 43.5 千兆赫(包括 43.5 千兆赫)的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 1 瓦(30 dBm)；
- (e) 額定於 43.5 千兆赫以上的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 0.1 納瓦(-70 dBm)；

註釋：

1. 如晶體管的額定操作頻率，涵蓋列於超過一個頻率範圍(由項目 3A001(b)(3)(a) 至 3A001(b)(3)(e)所界定)的頻率，該晶體管的管制狀況，須按當中最低的峰值飽和功率輸出限度斷定。
2. 項目 3A001(b)(3)包括裸芯片、安裝在承載體上的芯片、或安裝在包裝上的芯片。部分離散晶體管可稱為功率放大器，但該等離散晶體管的管制狀況，須按項目 3A001(b)(3)斷定。”。

(7) 附表 1，兩用物品清單，類別 3，項目 3A001(b)(4) —

- (a) 廢除在注意之前的所有字句  
代以  
“(4) 符合任何下述說明的固態微波放大器及含有固態微波放大器的微波組件／模組：  
(a) 額定於 2.7 千兆赫以上至 6.8 千兆赫(包括 6.8 千兆赫)的頻率操作，而“分頻寬”超過 15%，並具有任何下述特性：  
(1) 在 2.7 千兆赫以上至 2.9 千兆赫(包括 2.9 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 500 瓦(57 dBm)；  
(2) 在 2.9 千兆赫以上至 3.2 千兆赫(包括 3.2 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 270 瓦(54.3 dBm)；  
(3) 在 3.2 千兆赫以上至 3.7 千兆赫(包括 3.7 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 200 瓦(53 dBm)；  
(4) 在 3.7 千兆赫以上至 6.8 千兆赫(包括 6.8 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 90 瓦(49.54 dBm)；  
(b) 額定於 6.8 千兆赫以上至 31.8 千兆赫(包括 31.8 千兆赫)的頻率操作，而“分頻寬”超過 10%，並具有任何下述特性：  
(1) 在 6.8 千兆赫以上至 8.5 千兆赫(包括 8.5 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 70 瓦(48.54 dBm)；  
(2) 在 8.5 千兆赫以上至 12 千兆赫(包括 12 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 50 瓦(47 dBm)；

- (3) 在 12 千兆赫以上至 16 千兆赫(包括 16 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 30 瓦(44.77 dBm)；
- (4) 在 16 千兆赫以上至 31.8 千兆赫(包括 31.8 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 20 瓦(43 dBm)；
- (c) 額定於 31.8 千兆赫以上至 37 千兆赫(包括 37 千兆赫)的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 0.5 瓦(27 dBm)；
- (d) 額定於 37 千兆赫以上至 43.5 千兆赫(包括 43.5 千兆赫)的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 2 瓦(33 dBm)，而“分頻寬”超過 10%；
- (e) 額定於 43.5 千兆赫以上的頻率操作，並具有任何下述特性：
  - (1) 在 43.5 千兆赫以上至 75 千兆赫(包括 75 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 0.2 瓦(23 dBm)，而“分頻寬”超過 10%；
  - (2) 在 75 千兆赫以上至 90 千兆赫(包括 90 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 20 毫瓦(13 dBm)，而“分頻寬”超過 5%；
  - (3) 在 90 千兆赫以上的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 0.1 納瓦(-70 dBm)；
- (f) 額定於 2.7 千兆赫以上的頻率操作，並具有所有下述特性：
  - (1) 峰值飽和功率輸出( $P_{sat}$ )(以瓦特計算)大於 400 除以最高操作頻率(以千兆赫計算)的二 次 方  $[P_{sat} > 400 \text{ W} * \text{GHz}^2 / f_{\text{GHz}}^2]$ ；

- (2) “分頻寬”為 5%或以上；
- (3) 任何成直角的兩邊的其中一邊長度(d)(以厘米計算)相等於或少於 15 除以最低操作頻率(以千兆赫計算) $[d \leq 15 \text{ cm} * \text{GHz} / f_{\text{GHz}}]$ ；  
技術註釋：  
就具有向下延展至 2.7 千兆赫及以下的額定操作範圍的放大器而言，在項目 3A001(b)(4)(f)(3)的公式中，應使用 2.7 千兆赫作為最低操作頻率( $f_{\text{GHz}}$ ) $[d \leq 15 \text{ cm} * \text{GHz} / 2.7 \text{ GHz}]$ 。;
- (b) 廢除註釋 2  
代以  
“2. 如物品的額定操作頻率，涵蓋列於超過一個頻率範圍(由項目 3A001(b)(4)(a)至 3A001(b)(4)(e)所界定)的頻率，該物品的管制狀況，須按當中最低的峰值飽和功率輸出限度斷定。”。
- (8) 附表 1，兩用物品清單，類別 3，項目 3A001(e)(2)，注意，在“3A201(a)”之後 —  
加入  
“及軍需物品清單”。
- (9) 附表 1，英文文本，兩用物品清單，類別 3，項目 3A001(h)，註釋 3，在““modules””之後 —  
加入逗號。
- (10) 附表 1，兩用物品清單，類別 3，項目 3A002(a) —  
廢除在項目 3A002(a)(5)之前的所有字句  
代以  
“(a) 以下的記錄裝備及示波器：”。
- (11) 附表 1，兩用物品清單，類別 3，項目 3A002(a)(5)(b) —

- 廢除  
“連續輸出流通率”  
代以  
“連續輸出流通率”為。  
(12) 附表 1，兩用物品清單，類別 3，項目 3A002(a)(5) —  
廢除技術註釋  
代以  
“技術註釋：  
1. 就具有平行匯流排結構的儀器而言，‘連續輸出流通率’為最高字元率乘以一個字元內的位元數。  
2. ‘連續輸出流通率’是儀器在維持其採樣率及模擬一數字轉換時不會損失任何資訊下，能輸出至巨量貯存器的最快數據率。”。  
(13) 附表 1，兩用物品清單，類別 3 —  
廢除項目 3A002(a)(6)  
代以  
“(6) 使用磁碟貯存技術，並具有所有下述特性的數碼儀器資料記錄器系統，以及為該系統而特別設計的數碼記錄器：  
(a) 數碼化儀器資料速率，相等於或超過每秒 1 億個樣本(解析度為 8 位元或以上)；  
(b) ‘連續輸出流通率’為 1 千兆位元／秒或以上；  
技術註釋：  
數碼儀器資料記錄器系統，可配置嵌入或不嵌入數碼記錄器的數字化機。  
(7) 在符合下述說明的垂直量程設定的情況下，具有全標度少於 2% 垂直均方根值(rms)雜訊電壓的實時示波

- 器：在 3 分貝頻寬為 60 千兆赫或以上的每個頻道輸入，能得出最低雜訊值；  
註釋：  
項目 3A002(a)(7) 不適用於相等時間採樣的示波器。”。  
(14) 附表 1，兩用物品清單，類別 3，項目 3A002(d)(1)，在“的脈衝”之後 —  
加入  
“調制的訊號”。  
(15) 附表 1，兩用物品清單，類別 3，項目 3A002(d) —  
廢除技術註釋 2  
代以  
“2. 就項目 3A002(d)(1)(a)而言，‘脈衝持續時間’須界定為由達到 50% 脈衝振幅的前緣至達到 50% 脈衝振幅的後緣所需的時間。”。  
(16) 附表 1，兩用物品清單，類別 3，項目 3C005，在“鎢的”之後 —  
加入  
“半導體”。  
(17) 附表 1，兩用物品清單，類別 3，項目 3E002(b) —  
廢除  
“兩”  
代以  
“四”。  
(18) 附表 1，兩用物品清單，類別 4，項目 4A003(b) —  
廢除  
“3.0”

- 代以  
“8.0”。
- (19) 附表 1，兩用物品清單，類別 4，在項目 4A004 之後 —  
加入  
“4A005 為製作、操作或傳送“入侵軟件”，或為與“入侵軟件”通訊而特別設計或改裝的系統、裝備及該系統及裝備的部件；”。
- (20) 附表 1，兩用物品清單，類別 4，項目 4D001(b)(1) —  
廢除  
“0.25”  
代以  
“0.60”。
- (21) 附表 1，兩用物品清單，類別 4，在項目 4D003 之後 —  
加入  
“4D004 為製作、操作或傳送“入侵軟件”，或為與“入侵軟件”通訊而特別設計或改裝的“軟件”；”。
- (22) 附表 1，兩用物品清單，類別 4，項目 4E001(b)(1) —  
廢除  
“0.25”  
代以  
“0.60”。
- (23) 附表 1，兩用物品清單，類別 4，在項目 4E001(b)之後 —  
加入  
“(c) 供“發展”“入侵軟件”的“技術”；”。
- (24) 附表 1，英文文本，兩用物品清單，類別 5，第 1 部，項目 5A001(b)(1)(d)，在“(LEDs)”之後 —  
加入逗號。

- (25) 附表 1，兩用物品清單，類別 5，第 1 部，項目 5A001(b)(5)(b) —  
廢除  
““頻率切換時間””  
代以  
“頻道切換時間”。
- (26) 附表 1，兩用物品清單，類別 5，第 1 部，項目 5A001(b)(5) —  
廢除  
在“的類型；”之後的所有字句  
代以  
“註釋：  
項目 5A001(b)(5)不適用於特別設計供與民用蜂巢式無線電通訊系統一起使用的無線電裝備。  
技術註釋：  
‘頻道切換時間’：由一接收頻率轉到另一接收頻率，以達到最後指明的接收頻率，或其±0.05%的範圍以內所需的時間(即延時)。如物品的指明頻率範圍少於其中心頻率的±0.05%，則該物品界定為不能進行頻道頻率切換。”。
- (27) 附表 1，兩用物品清單，類別 5，第 1 部，在項目 5A001(h)之後 —  
加入  
“(i) 不使用；  
(j) 具有所有下述特性的互聯網規約網絡通訊監察系統或裝備，以及為該系統或裝備而特別設計的部件：  
(1) 在傳送商級互聯網規約網絡(例如：國家級互聯網規約主幹網絡)下進行所有下述操作：

- (a) 在應用層分析(例如：開放式系統互連(OSI)模型(ISO/IEC 7498-1)的第 7 層)；
  - (b) 抽取選定的元數據及應用內容(例如：語音、視象、訊息、附件)；
  - (c) 製作所抽取數據的索引；
- (2) 為進行所有下述操作而特別設計：
- (a) 在‘硬選擇器’的基礎上執行搜尋；
  - (b) 測繪個人或一羣人的關係網絡；

**註釋：**

項目 5A001(j)不適用於為任何下述項目而特別設計的系統或裝備：

- (a) 推銷用途；
- (b) 網絡服務質量(QoS)；
- (c) 用戶體驗質量(QoE)。

**技術註釋：**

關於個人的‘硬選擇器’資料或資料組合(例如：姓氏、名字、電郵地址、街道地址、電話號碼或從屬團體)。”。

(28) 附表 1，兩用物品清單，類別 5，第 1 部 —

**廢除項目 5E001(d)**

代以

- “(d) 按照一般技術註釋，供“發展”或“生產”為電訊而特別設計的微波“單塊集成電路”(MMIC)功率放大器的“技術”，並具有任何下述特性：

**技術註釋：**

就項目 5E001(d)而言，在產品資料單張中，參數峰值飽和功率輸出可稱為輸出功率、飽和功率輸出、最大功率輸出、峰值功率輸出或峰包功率輸出。

- (1) 額定於 2.7 千兆赫以上至 6.8 千兆赫(包括 6.8 千兆赫)的頻率操作，而“分頻寬”超過 15%，並具有任何下述特性：
  - (a) 在 2.7 千兆赫以上至 2.9 千兆赫(包括 2.9 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 75 瓦(48.75 dBm)；
  - (b) 在 2.9 千兆赫以上至 3.2 千兆赫(包括 3.2 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 55 瓦(47.4 dBm)；
  - (c) 在 3.2 千兆赫以上至 3.7 千兆赫(包括 3.7 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 40 瓦(46 dBm)；
  - (d) 在 3.7 千兆赫以上至 6.8 千兆赫(包括 6.8 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 20 瓦(43 dBm)；
- (2) 額定於 6.8 千兆赫以上至 16 千兆赫(包括 16 千兆赫)的頻率操作，而“分頻寬”超過 10%，並具有任何下述特性：
  - (a) 在 6.8 千兆赫以上至 8.5 千兆赫(包括 8.5 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 10 瓦(40 dBm)；
  - (b) 在 8.5 千兆赫以上至 16 千兆赫(包括 16 千兆赫)的任何頻率，峰值飽和功率輸出超過 5 瓦(37 dBm)；
- (3) 額定於 16 千兆赫以上至 31.8 千兆赫(包括 31.8 千兆赫)的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 3 瓦(34.77 dBm)，而“分頻寬”超過 10%；
- (4) 額定於 31.8 千兆赫以上至 37 千兆赫(包括 37 千兆赫)的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 0.1 納瓦(-70 dBm)；

- (5) 額定於 37 千兆赫以上至 43.5 千兆赫(包括 43.5 千兆赫)的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 1 瓦(30 dBm)，而“分頻寬”超過 10%；
- (6) 額定於 43.5 千兆赫以上至 75 千兆赫(包括 75 千兆赫)的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 31.62 毫瓦(15 dBm)，而“分頻寬”超過 10%；
- (7) 額定於 75 千兆赫以上至 90 千兆赫(包括 90 千兆赫)的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 10 毫瓦(10 dBm)，而“分頻寬”超過 5%；
- (8) 額定於 90 千兆赫以上的任何頻率操作，操作時峰值飽和功率輸出超過 0.1 納瓦(-70 dBm)；”。
- (29) 附表 1，兩用物品清單，類別 5，第 2 部，在項目 5A2 之前的註釋 3(b)，在“硬部件”之後 —  
加入  
“或‘可執行軟件’”。
- (30) 附表 1，兩用物品清單，類別 5，第 2 部，在項目 5A2 之前的註釋 3(b)，在所有“該部件”之後 —  
加入  
“或‘可執行軟件’”。
- (31) 附表 1，兩用物品清單，類別 5，第 2 部，在項目 5A2 之前的註釋 3(b)(4)之後 —  
加入  
“技術註釋：  
就密碼學註釋而言，‘可執行軟件’指出自被密碼學註釋豁除於項目 5A002 之外的現有硬部件的、屬可執行形式的“軟件”。  
註釋：

- ‘可執行軟件’不包括在最終物品運行的“軟件”的完整二進制影像。”。
- (32) 附表 1，兩用物品清單，類別 5，第 2 部，在項目 5A2 之前的技術註釋 —  
廢除該技術註釋。
- (33) 附表 1，兩用物品清單，類別 5，第 2 部，項目 5A002(a)(1) —  
(a) 廢除技術註釋 3；  
(b) 廢除註釋。
- (34) 附表 1，兩用物品清單，類別 5，第 2 部，在項目 5A002(a)(1)(a)之後 —  
加入  
“技術註釋：  
在類別 5 第 2 部中，奇偶檢驗位並不包括在密碼匙長度內。”。
- (35) 附表 1，兩用物品清單，類別 5，第 2 部，項目 5A002(a)(9)，在“使用”之後 —  
加入  
“或執行”。
- (36) 附表 1，兩用物品清單，類別 5，第 2 部，項目 5A002，在註釋(j)之後 —  
加入  
“(k) 設計供民用、並符合密碼學註釋(類別 5 第 2 部註釋 3)(a)(2)至(5)段的條文的流動通訊無線電接入網絡(RAN)裝備，而該裝備具有的射頻輸出功率限於 0.1 瓦(20 dBm)或以下，及支援 16 名或以下同步使用者；”。
- (37) 附表 1，詞語定義，密碼學的定義，在技術註釋之前 —  
加入

“註釋：

“密碼學”不包括“固定式”資料壓縮或編碼技術。”。

(38) 附表 1，詞語定義，**頻率切換時間**的定義 —  
廢除

“3 5 “頻率切換時間” (Frequency switching time)”  
代以

“3 “頻率切換時間” (Frequency switching time)”。

(39) 附表 1，詞語定義 —  
按筆劃數目順序加入

“4 “入侵軟件” (Intrusion software)

為避開電腦或具網絡功能的裝置的‘監控工具’的偵測，或為解除電腦或具網絡功能的裝置的‘保護性反制措施’而特別設計或改裝的“軟件”，並執行任何下述功能：

- 由電腦或具網絡功能的裝置抽取數據或資料，或修改系統或用戶數據；
- 修改程式或程序的標準執行路徑，以容許執行外部提供的指令。

註釋：

- “入侵軟件”不包括任何下述項目：
  - 虛擬機器監察器、排錯程式或軟件反向工程(SRE)工具；
  - 數碼權管理(DRM)“軟件”；
  - 設計供製造商、管理人員或使用者為資產追蹤或恢復的用途而安裝的“軟件”。
- 具網絡功能的裝置，包括流動裝置及智能電錶。

技術註釋：

1. ‘監控工具’：監察在裝置上運行的系統行為或程序的“軟件”或硬件裝置，包括防毒(AV)產品、端點保安產品、個人保安產品(PSP)、網絡入侵偵測系統(IDS)、網絡入侵防禦系統(IPS)或防火牆。

2. ‘保護性反制措施’：為確保安全執行編碼而設計的技術，例如資料執行防止(DEP)、位址空間配置隨機(ASLR)或沙箱。

3 “三維集成電路” (Three dimensional integrated circuit)

整合在一起的一羣組半導體芯片，並具有可完全穿過最少一片芯片的微孔以建立在芯片之間的相互聯繫。”。

李青宇

工業貿易署署長

2015 年 / 月 22 日

註釋

本命令修改《進出口(戰略物品)規例》(第 60 章, 附屬法例 G)(《規例》)附表 1, 以反映瓦塞納安排所採納的對戰略物品管制清單的最新更改。本命令亦對《規例》附表 1 作出輕微的文字上的修訂。

## 附件 B

### **對經濟的影響**

放寬對三類戰略物品（即電子、電腦、電訊及資訊安全產品）的若干項目的管制能夠省卻相關貿易和物流商就該等物品申領進出口許可證這將有利提升營運效率並間接降低營運成本。另一方面，由於被納入管制的部份較敏感產品不屬香港主要貿易項目，因此對進出口貿易的影響不大。